

Title (en)

TAPE AUTOMATED BONDED LEAD PACKAGE AND REUSABLE TRANSPORT TAPE FOR USE THEREWITH.

Title (de)

LEITERPACKUNG FÜR DIE AUTOMATISCHE BANDMONTAGE SOWIE WIEDERVERWENDBARES TRANSPORTBAND FÜR DIE VERWENDUNG BEI DER MONTAGE.

Title (fr)

BO TIER DE FILS A BONDERISATION AUTOMATIQUE A FILM ET FILM DE TRANSPORT REUTILISABLE UTILISE AVEC LEDIT BOITIER.

Publication

EP 0406373 A1 19910109 (EN)

Application

EP 90900714 A 19891207

Priority

US 28101688 A 19881207

Abstract (en)

[origin: WO9006593A1] A lead pack which includes a rectangular frame (18, 28) of polymer insulating material and a plurality of leads (34) imbedded in said frame and extending inwardly and outwardly therefrom for attachment to an associated integrated circuit and for attachment of the leaded integrated circuit to an associated printed wiring board or like circuit. The insulating frame serves as a dam or sealing means in an encapsulating process. An additional frame (29) stabilizes and positions. The outwardly extending ends of the leads (34). A reusable transport and test tape (12) which includes a plurality of leads (62) adapted to receive and connect to the leads (34) of the lead pack and the position the lead pack for reception of an integrated circuit for bonding of lead pack leads to the contact pads of the integrated circuit and to move the lead pack and integrated circuit into succeeding processing stations where the circuit is packaged and tested, and then excised.

Abstract (fr)

L'invention concerne un boîtier de conducteurs comprenant une structure rectangulaire (18, 28) en matériau polymère isolant, ainsi qu'une pluralité de conducteurs (34) insérés dans ladite structure et s'étendant intérieurement et extérieurement dans et hors celle-ci, destiné à être fixé à un circuit intégré associé et destiné à la fixation du circuit intégré à conducteurs à une plaquette de câblage imprimé associée ou à un circuit analogue. La structure d'isolation sert de barrage ou de moyen de fermeture hermétique dans un procédé d'encapsulation. Une structure additionnelle (29) stabilise et positionne les extrémités des conducteurs (34) s'étendant extérieurement. Elle concerne également un film (12) de transport et de test réutilisable comprenant une pluralité de conducteurs (62) adaptée pour la réception et la connexion aux conducteurs (34) du boîtier de conducteurs aux plots de contact du circuit intégré, et pour déplacer le boîtier de conducteurs ainsi que le circuit intégré dans des postes de traitement successifs où le circuit est mis en boîtier et testé, puis coupé.

IPC 1-7

H01L 23/48; **H01L 29/48**; **H01L 29/52**; **H01L 29/60**

IPC 8 full level

H01L 21/60 (2006.01); **H01L 21/68** (2006.01); **H01L 23/495** (2006.01); **H01L 23/498** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01L 21/6835 (2013.01); **H01L 23/49572** (2013.01); **H01L 23/4985** (2013.01); **H01L 24/50** (2013.01); **H01L 24/86** (2013.01); **H01L 2924/01029** (2013.01); **H01L 2924/01033** (2013.01); **H01L 2924/01039** (2013.01); **H01L 2924/01057** (2013.01); **H01L 2924/01078** (2013.01); **H01L 2924/01079** (2013.01); **H01L 2924/01082** (2013.01); **H01L 2924/14** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

WO 9006593 A1 19900614; EP 0406373 A1 19910109; EP 0406373 A4 19920429; JP H03505146 A 19911107

DOCDB simple family (application)

US 8905431 W 19891207; EP 90900714 A 19891207; JP 50136090 A 19891207